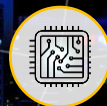


nejes

Investor Presentation

Semiconductor | IT materials | Energy



2026.07.08



Part 01

OVERVIEW



Introduction



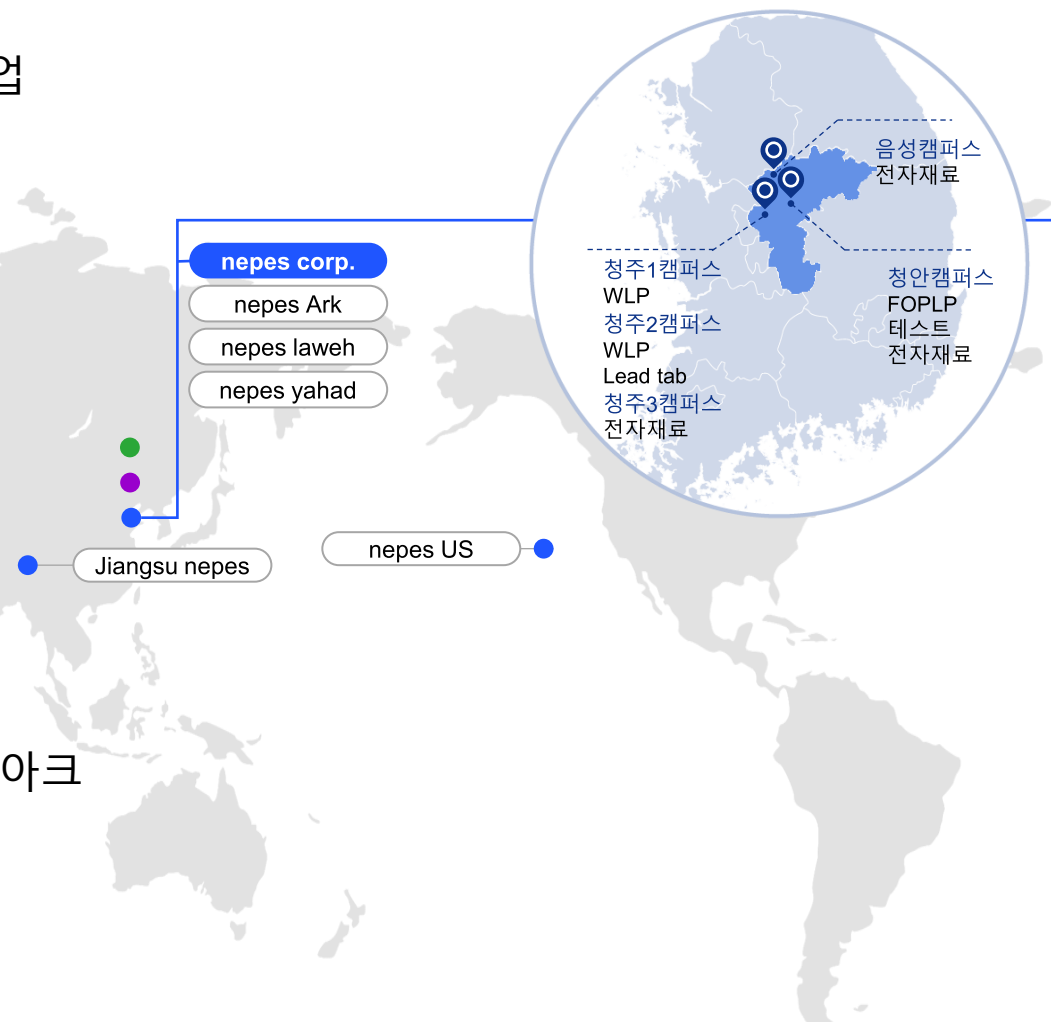
네패스는 지속가능한 성장을 실현하는 첨단 반도체 패키징 전문 기업



‘네패스’는 ‘영원한 생명(Eternal Life)’ 을 뜻하는 히브리어로 강인한 생명력과 지속 성장을 지향하는 회사의 비전을 상징합니다.

OVERVIEW

회사명	네패스	대표이사	이병구, 이창우
설립일	1990/12/27(상장일: 1999/12/14)	상장주식수	23,059,202
주요 사업	첨단 반도체 패키징 서비스		
국내 사업장	<ul style="list-style-type: none"> 반도체: 충북(청주, 괴산) 전자재료: 충북(음성, 청주, 괴산), 온산 이차전지: 충북(청주, 괴산) 		



지속 성장을 꿈꾸는 시스템 반도체 테스트 솔루션 전문 기업 네패스아크



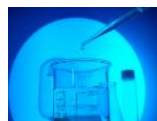
아크의 어원 (Noah's Ark, 노아의 방주)

검증과 선별의 기능을 담당하는 테스트 솔루션 전문 기업을 의미

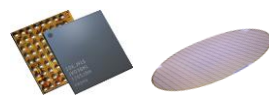
OVERVIEW

회사명	네패스 아크	대표이사	이병구, 이창우
설립일	2019.04.01(상장일: 2020/11/17)	상장주식수	12,184,045주

- Semiconductor
- Energy
- IT materials
- Artificial Intelligence



1992
전자재료 사업 시작
[음성]
디스플레이&반도체용 케미컬
양산



2000
반도체 사업 본격화

[오창]
시스템반도체 WLP&테스트 사업 진출



2006
nepes Pte.
싱가포르 JV 설립



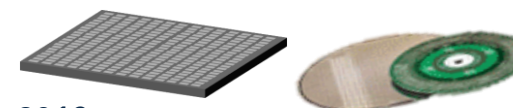
2009
[오창] WLP
제 2 양산 공장 준공



2015
Fan-out WLP 양산 시작



2017 nejes yahad
이차전지 사업 전환

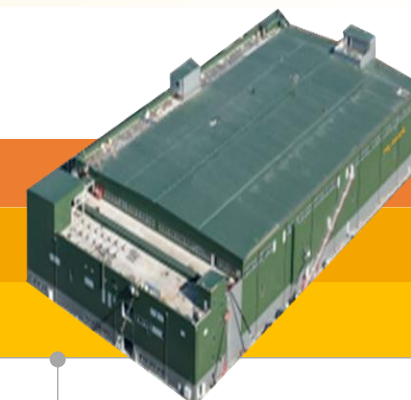


2019
600mm FOPLP 양산 시작



2019
테스트 사업 분사
nejes Ark

2019
[괴산 청안]
600mm FOPLP 팹 준공
nejes laweh



2023
[괴산 청안]
테스트 팹 / 케미컬 팹 준공



Part 02

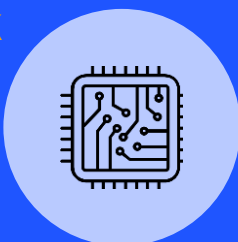
CORE COMPETENCE



Core Competence

첨단 패키징, 전자재료, 2차전지 부품 사업의 기술 역량을 기반으로 AI 시대의 통합적 경쟁력을 확보

nepes
nepes Ark



Semiconductor

저전력, 고성능,
모듈화(Integration) 패키징 기술

- Bumping
- WLP
- FOWLP/PLP
- SiP
- **TEST**

Smartphone, Automotive, AI Server

nepes



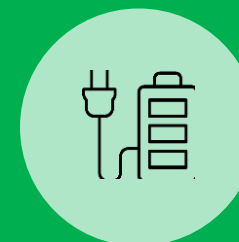
IT Materials

고순도, 균일 품질, 공정
신뢰성을 높이는 소재 기술

- Cu plating
- Photo Resist
- PSPI
- Stripper

Advanced packaging(WLP, HBM)

nepes (yahad)



Rechargeable battery

안정성, 고출력 기반의
ESS/EV/HEV 대응 기술

- Lead-tab
- TBA
- FRC

Automotive, Datacenter, Smart home

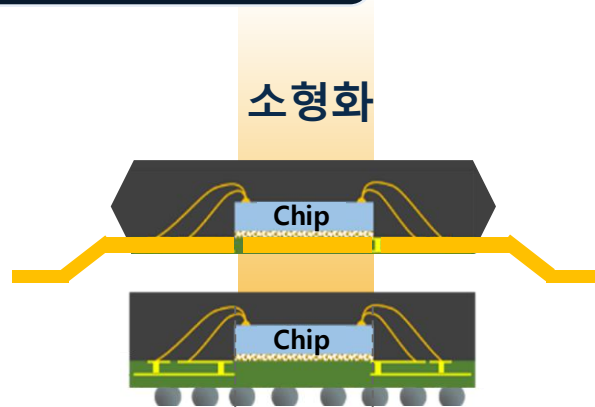


첨단패키징 기술 확대와 OSAT 업체의 기술 경쟁력 확보 필요

반도체 경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 **저전력, 고효율, 고집적**

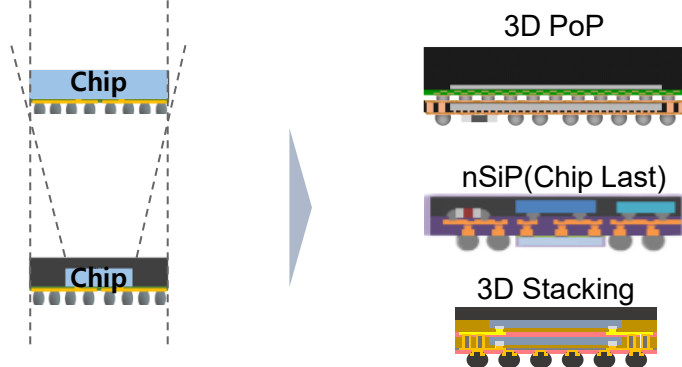
◆ Conventional PKG

- QFP (Quad Flat Package)
- BGA (Ball Grid Array)

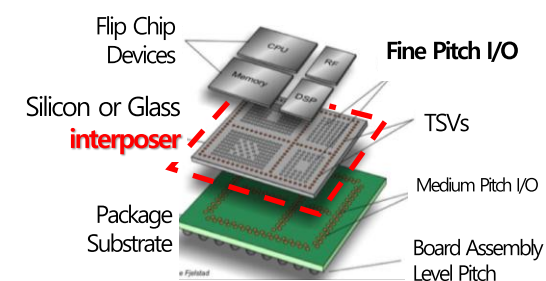
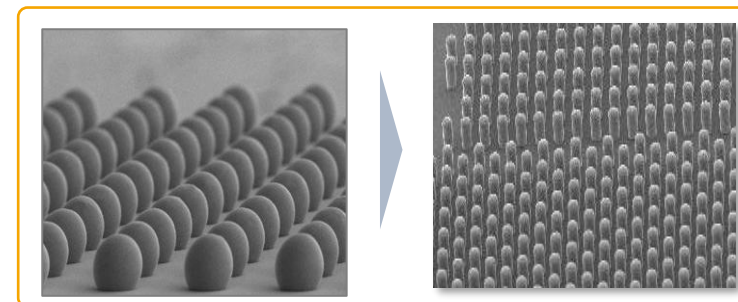


◆ Advanced PKG

- FIWLP (Fan-In Wafer Level Package)
- FOWLP/PLP (Fan-Out Wafer/ Panel Level Package)
- 2.5D/3D (Chiplet)



Copper Pillar Bump / 재배선(RDL) / 이중집적





Part 03

MARKET & CUSTOMER

글로벌 시스템 반도체 시장 성장

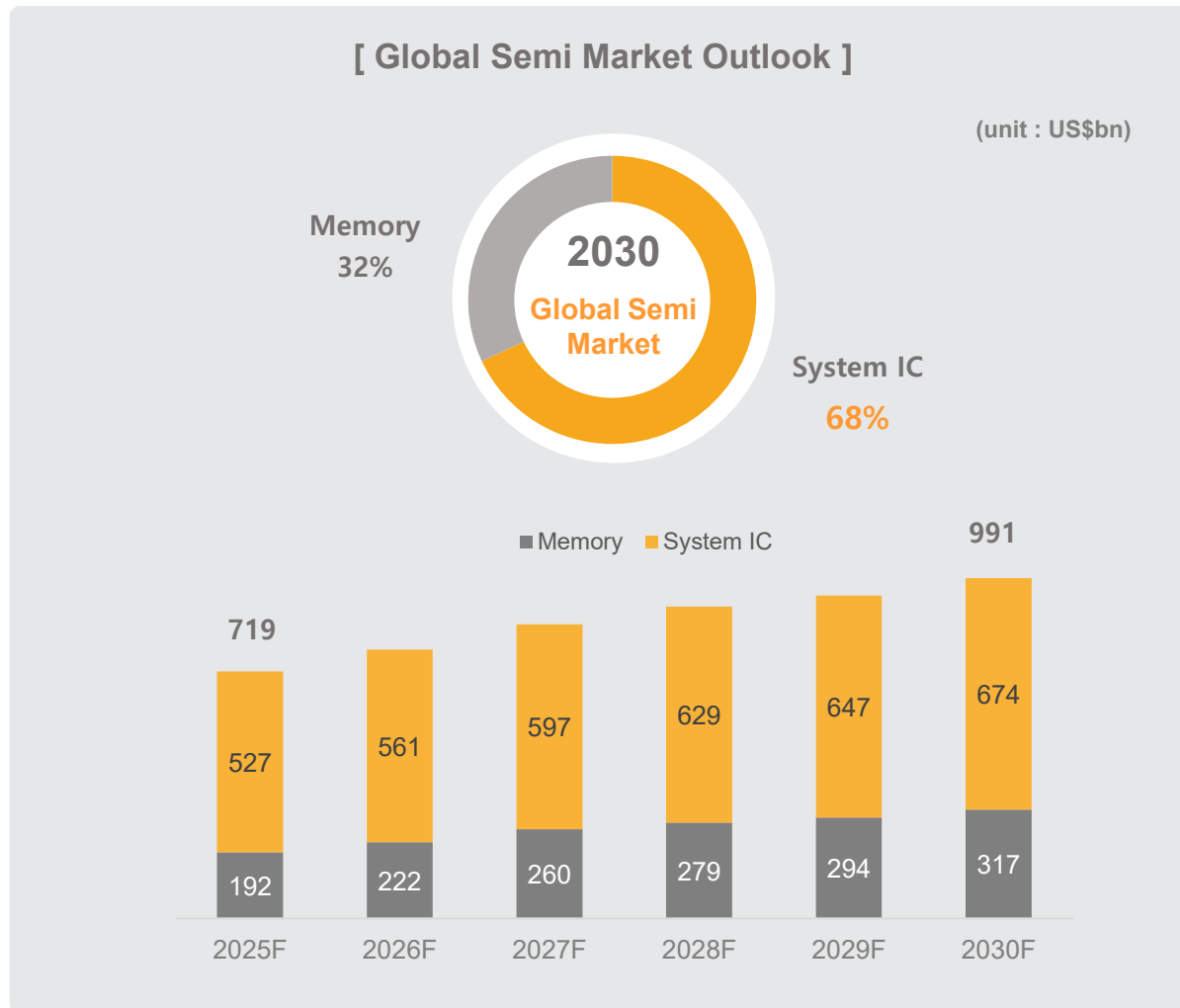
글로벌 반도체 시장의 성장을 견인하는 시스템 반도체

AI
6G 시장 및 AI, 데이터센터 등 반도체 시장 확대로 시스템 반도체 수요 급증

저전력
전력 사용의 절감 문제 해결이 Advanced 반도체의 핵심

Integration
자율주행차와 IoT 연결로 한 대의 자동차에 1,000개의 시스템 반도체 필요

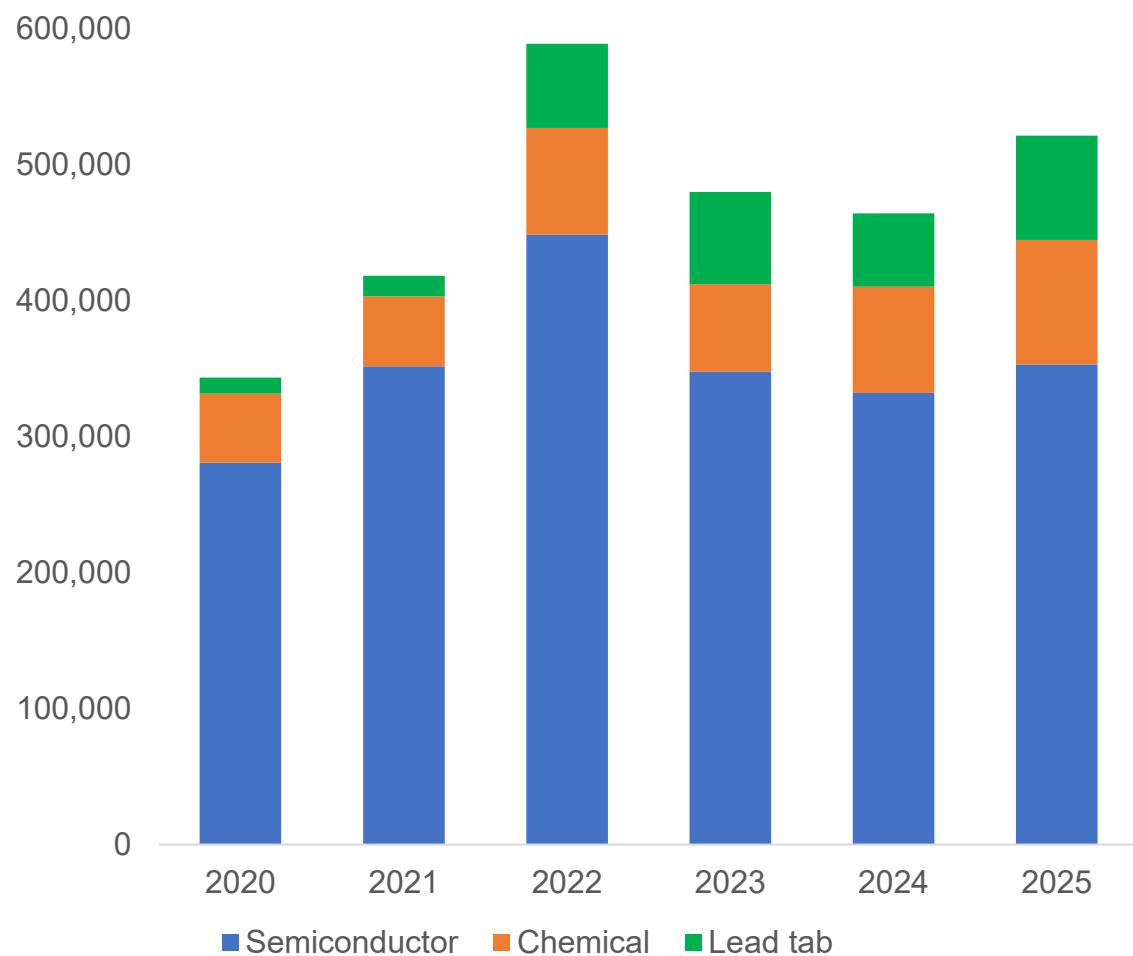
Expandability
수평 수직 적층을 통해 경박단소의 반도체 집적을 가능하게 진화



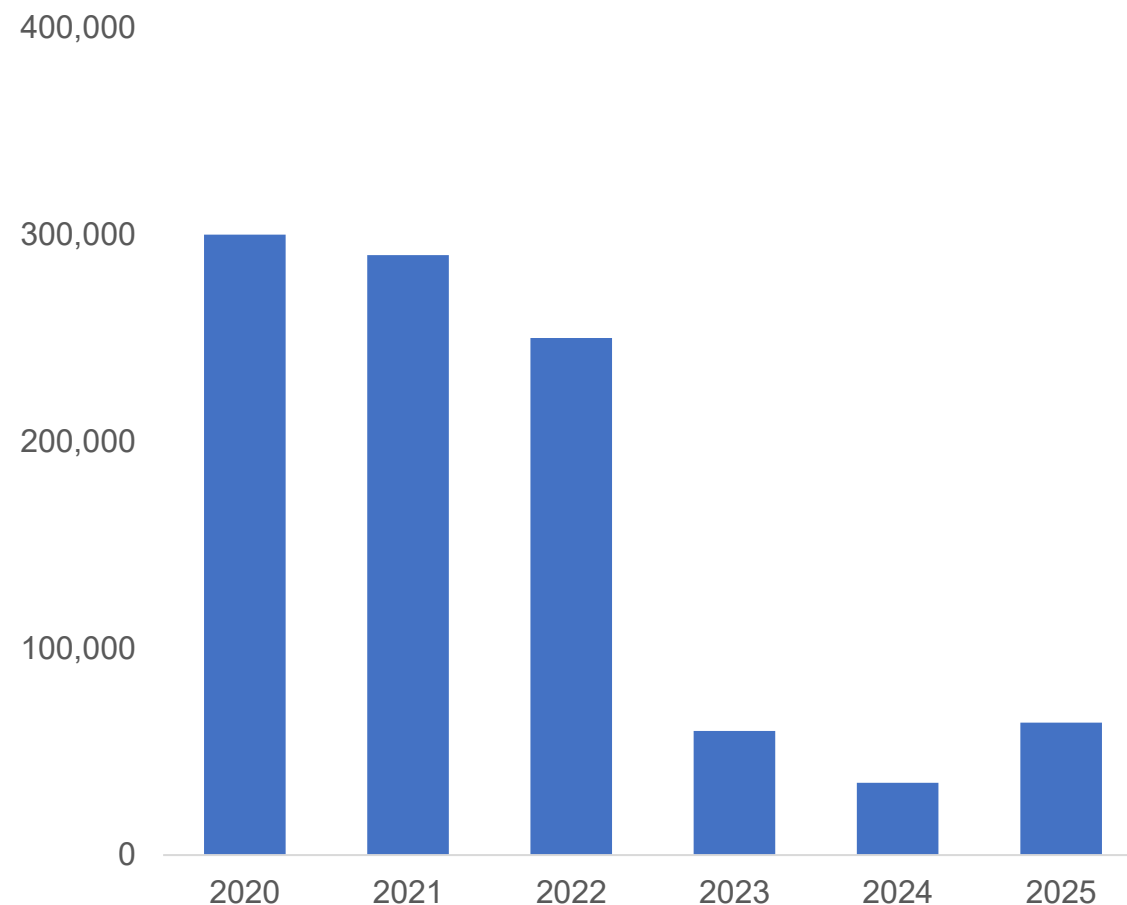
※ Source : PwC 2025.02

(백만원)

Revenue(2020-2025)



CAPEX(2020-2025)



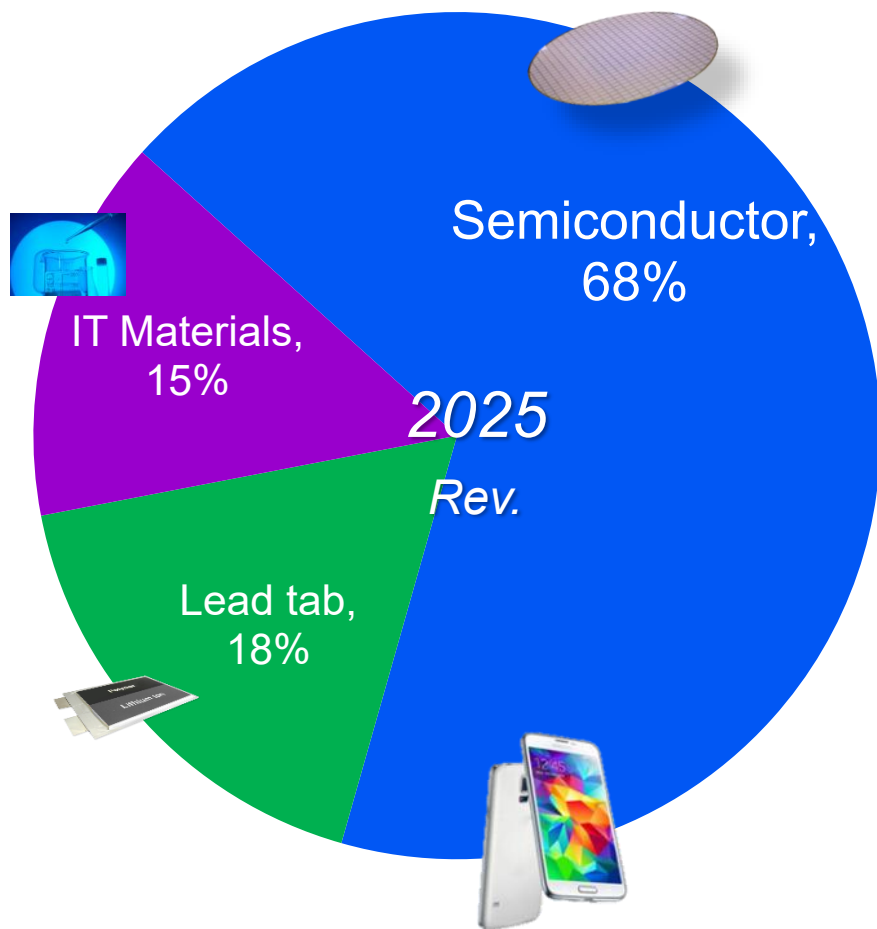


Part 04

BUSINESS OUTLOOK BY SERVICE



Business portfolio



■ Semiconductor ■ Lead tab ■ IT Materials

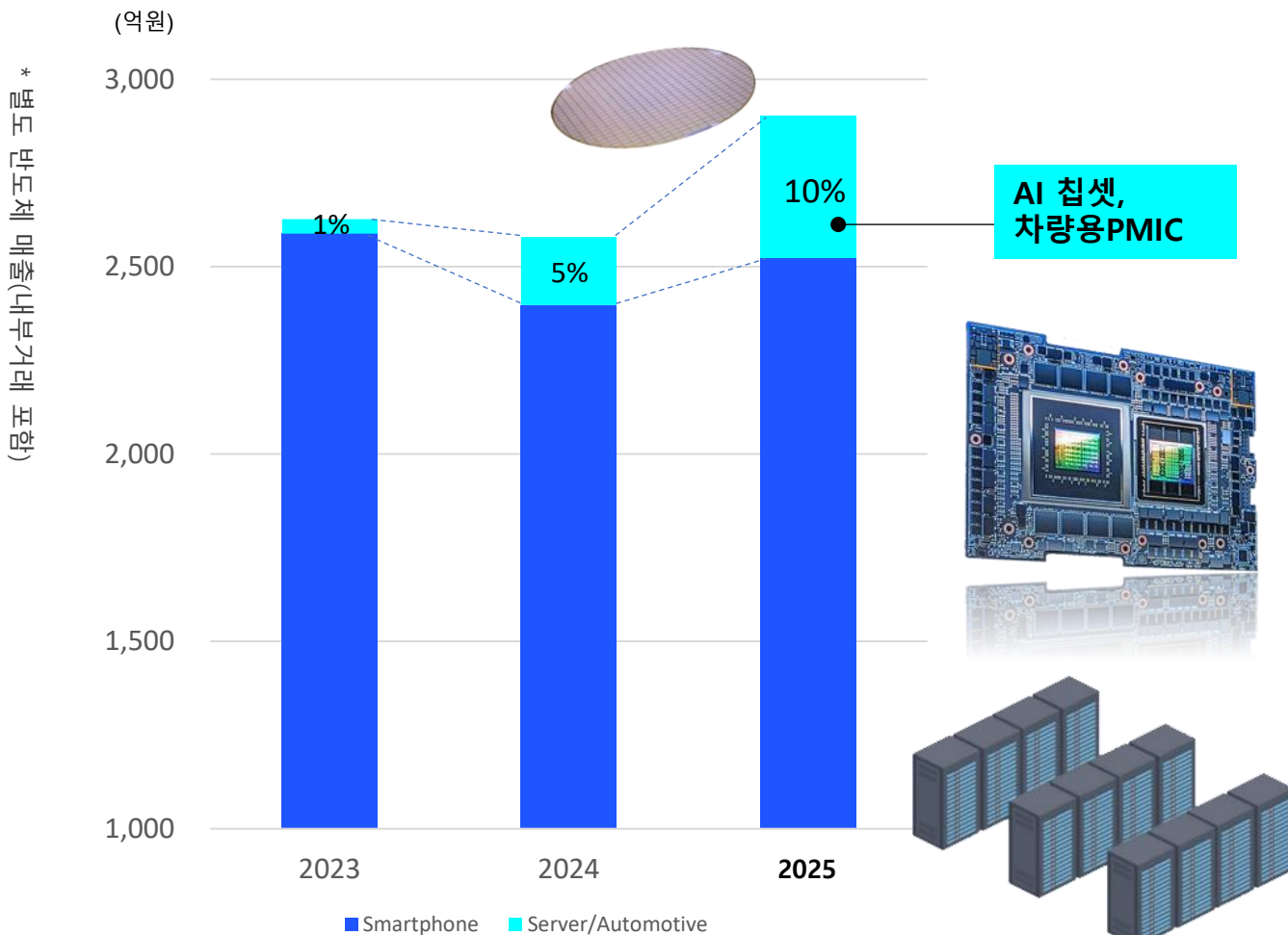
단위: 억원

법인	Biz.	2025	2024	YoY
네패스	● Semiconductor	4,110	3,930	4.6%
	● IT Materials	916	783	17%
	● Lead Tab	765	538	42%
	연결 매출액	5,207	4,636	12%
	연결 영업이익 (%)	237 (4.6%)	34 (0.7%)	597% (4.9%p)
네패스아크	● Semi(TEST) 매출	1,140	1,190	-4%
	Semi(TEST) 영업이익 (%)	48 (4%)	-26 (-2%)	후자전환 (6.4%p)

* 기타 포함 / 부분간 수익 제거



WLP 매출 추이



[2026년 전망]

- AI, 데이터 센터, 자율주행 등 확대
- 국내 파운드리 시설 증설에 따른 지속적인 수요가 예상 됨

[시장]

- AI 서버용 반도체 수요가 고성능 패키징 수요 촉발
- 지정학적 리스크로 제조 SCM 재편 가속

[현황·전략]

- AI 서버, Automotive 등 고성능 응용처 수주 확대
- 고수익 공정 비중 확대에 따른 수익성 개선
- 12" CPB 증설 결정, 차세대 고사양 패키징 인프라 확보

THREE STRATEGIC PILLARS

01

Core Business

Mobile & Consumer Application

- Stable cash-flow base supporting strategic re-investment

02

AI Infrastructure Solutions

Power Delivery

Power Management
Silicon Capacitor

Memory & Connectivity

Memory Controller

03

AI Advanced Packaging

2.5D Integration · Fan-Out / PLP

THREE STRATEGIC PILLARS

01

Strengthening Core Business

Global top-tier CIS customers

02

Co-growth with Strategic Foundries

Automotive AI, Robotics & Infotainment

03

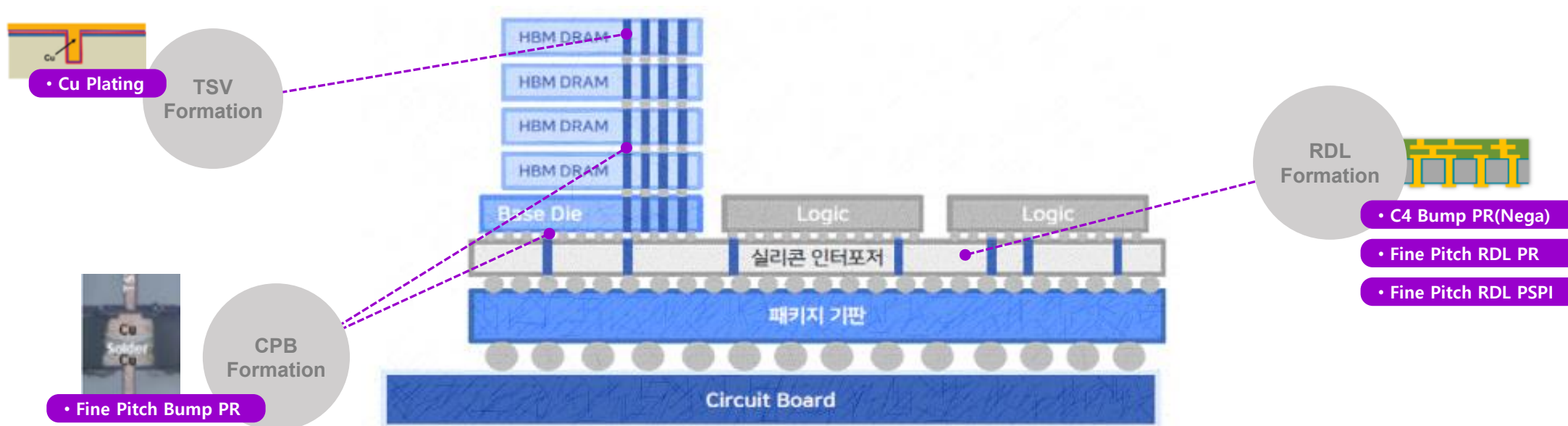
Turnkey Synergy with nepes

Advanced Package (2.5D, 3D, FoPLP)



IT Materials(전자재료)

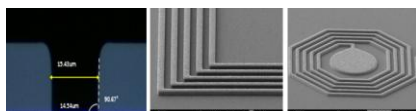
- 반도체 / 디스플레이 / 에너지 분야의 핵심 케미컬 소재 제조/판매(국내 Top tier 고객)
- High Purity Technology, 균일 품질 유지(Batch to batch) 역량으로 Advanced Package용 고성능 소재 Solution 제공



[2.5D Package 적용사례] source: e-best research

Product

- Cu 도금액, PSPI 절연막, Stripper
- Photo Resist, Developer
- Stripper, CNT 분산액



Applications

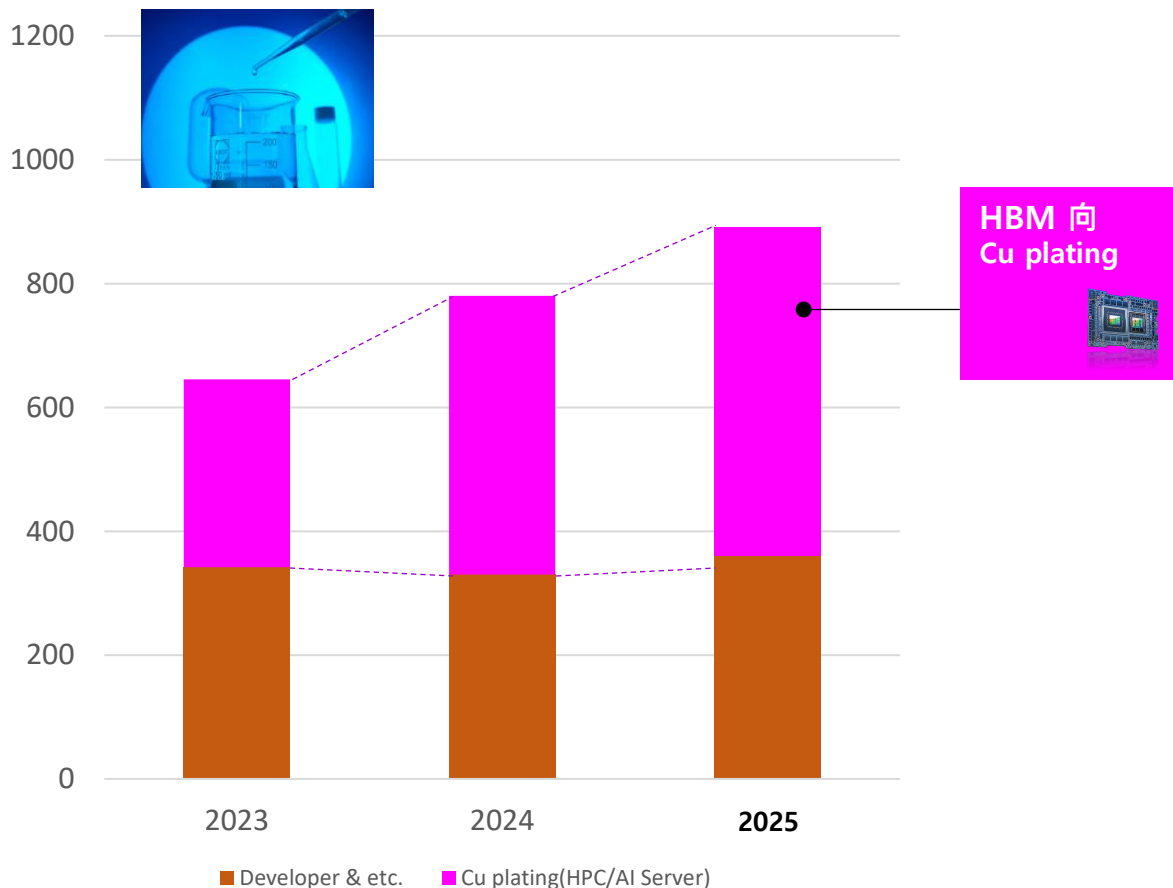
- HBM, DDR5
- System IC(AP, PMIC, DDI, etc.,)
- OLED display





전자재료 매출 추이

(억원)



[2026년 전망]

- 국내 반도체 제조사들의 국산화 가속
- HBM 재료 수요 증가 전망

[시장]

- 경제 제재 리스크로 반도체 재료 공급선 다변화 필요
- 반도체 고도화에 따른 첨단 패키징 소재 시장 확대

[현황·전략]

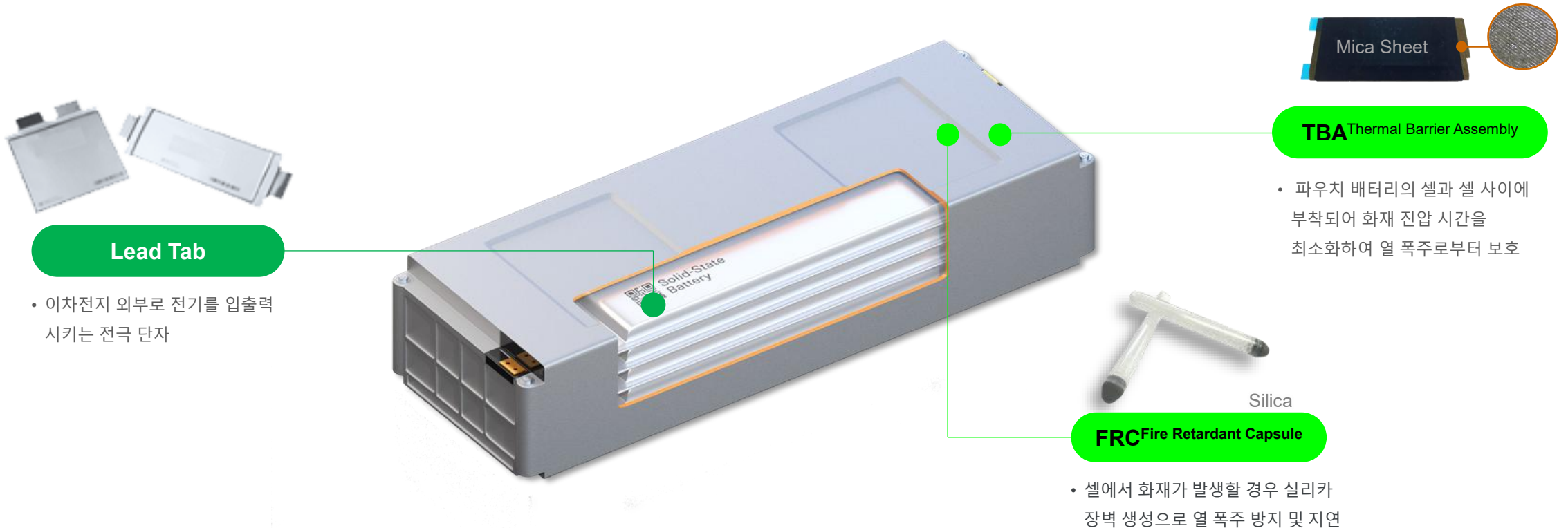
- HBM向 고기능성 재료 수요 확대에 따른 구조적 성장
- 첨단 패키징과 동반 성장하는 수직계열화 포지션 유지
- 高수익 제품 비중 증가/제조 운영 합리화로 수익성 개선



Lead tab(Rechargeable battery)

- ESS/EV에 탑재되는 파우치형 2차전지용 리드탭 제조·공급
- 전기차용 화재 지연 안전장치 부품·소재 개발 및 공급

- Battery Module
- Pouch Cell



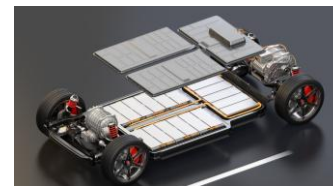
Service & Products

- Lead Tab
- Thermal barrier assembly
- LIB anode electrode

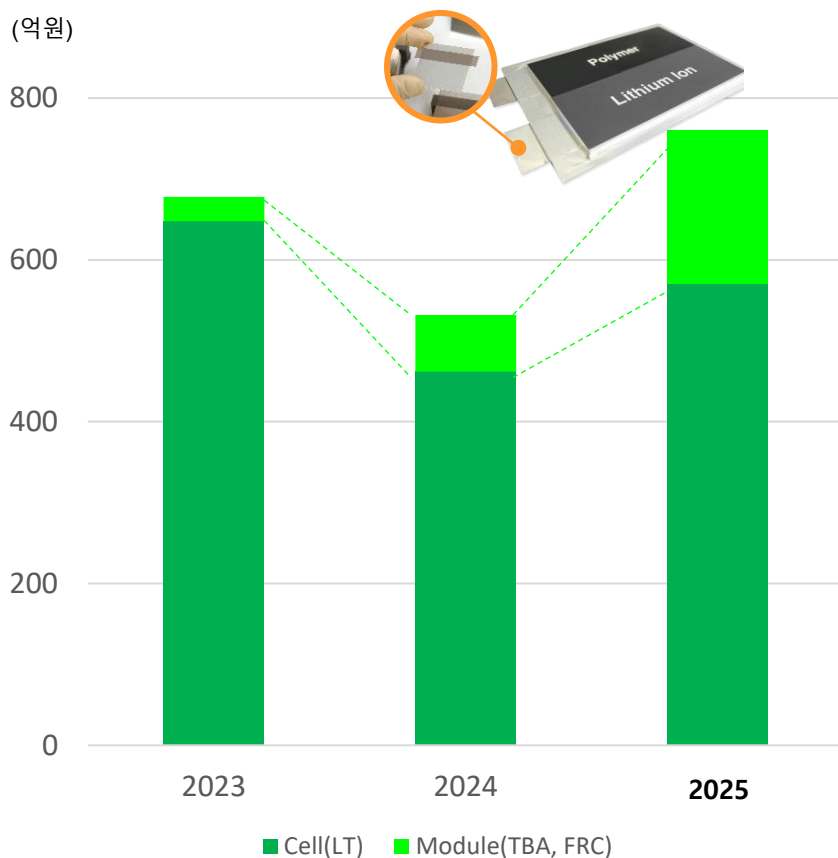


Applications

- EV/HEV
- ESS



Lead Tab 매출 추이



[2026년 전망]

- 전기차용 세이프티 부품 개발 요구 확대
- 화재지연 신제품 매출 확대 본격화

[시장]

- 일시적 EV성장세 둔화 및 배터리 가격 하락에 따른 수요 회복 모멘텀 상존

[현황·전략]

- 해외 고객사 양산 진입 등 고객 다양화 추진
- 화재지연 안전장치 등 신규 제품 양산 확대



네패스는 국가첨단산업을 이끄는
36년 업력의 충청북도 선도(앵커) 기업입니다.



nepes
nepes corporation

THANK YOU

To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Psalm 136:4

* A dandelion means 'Gratitude' in the language of flowers

nepes corporation

2415, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

Tel : 02-3470-2700

Fax : 02-3470-2708

URL: www.nepes.co.kr